



機台特點 Characteristics

- The Best Solution for Permanent Bonding to Improve Yield.
- Flexible process capability: WoW mode / Pre-anneal mode.
- Superior pressure & temperature uniformity.
- Max. pressure: 0.5MPa
- Max. temperature: 180°C
- Real time process status monitor.
- SECS/GEM compatible.



www.csun.com.tw

WPRA-A12 Pre anneal

電源 Power	AC220V 3Φ 60HZ 121A 46KVA
機台尺寸 Exterior (mm)	L4200 x W2210 x H2774(mm)
Wafer 尺寸 Dimension of wafer	直徑 Diameter : 299.5mm +/- 0.2mm 厚度 Thickness : 1365~1590um 翹曲 Warpage : +/- 500um
預退火模組 Pre-anneal module	真空度 Vacuum Range: 76mTorr/2min 溫度 Temperature: Max. 180°C (均勻度 Uniformity: 100°C ±2%) 壓力 Force: Max. 5kg/cm ² (3535kgf) (均勻度 Uniformity: >90% /0.5MPa->5Kgf/cm ²) WoW貼合精度 Bonding accuracy: X-Y精度 Accuracy: ≤100μm ; θ精度 Accuracy: ≤0.2° 模組數量 Accuracy: 2 離型膜模組張力 Release film module tension: Max.100N
AOI	解析度 Resolution: 4 x 16384 (pixel) 精度 Precision: 18.5 um FOV: 305.67 mm
Cooling 模組 Cooling module	制冷方式 Refrigeration: 氣冷 層數 Layer Count: 4 層
備註 Remark	無塵等級 Layer Count: CLASS 100 SECS/GEM 選配 (Optional) SEMI S2 report 及證書 (Certification)

Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.
受長期研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知

DM2023Q3-000-TW

+86-15962521975 (華東)

+86 13600293510 (華南)

+886 935221377 (臺灣)

eltonhsu@csun.com.tw

台北

新北市林口區工二工業區
工八路2-1號
TEL:886-2-26017706
FAX:886-2-26018854

台中

台中市南屯區
精科二路11號
TEL:886-4-23591651
FAX:886-4-23592678

廣州

廣州市花都區獅嶺鎮
利和路6號
TEL:86-20-86846341-3
FAX:86-20-86910139

東莞

東莞市大朗鎮長塘第三工業區78號
松湖雲谷雲松樓1樓
TEL:86-769-85331146
FAX:86-769-85331145

昆山

江蘇省昆山市高新區(玉山鎮)
恒盛路1369號
TEL:86-512-57780230
FAX:86-512-57780229